BEST AVAILABLE COPY PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-124690

(43) Date of publication of application: 28.04.2000

(51)Int.CI. r...... H05K 13/04

(21)Application number: 10-289786

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

12.10.1998

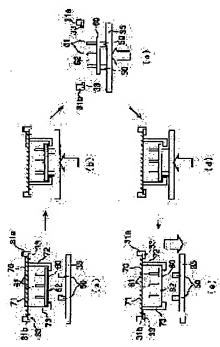
(72)Inventor: MOBARA MASAYUKI

OYAMA KAZUYOSHI **KURIHARA SHIGERU** SHUYAMA SHUJI

(54) SUBSTRATE-SETTING EQUIPMENT FOR MOUNTING APPARATUS AND SWITCHING OF **BACKUP PIN**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a substratesetting equipment of a mounting apparatus and a method for switching backup pins, wherein the time required for arrangement of a substrate is not effected by the working time for rearrangement of backup pins. SOLUTION: A backup pin plate 62 for setting upright many backup pins 61 removably is so built up as to be mounted and dismounted with respect to an elevation mechanism 35, 36 for moving the backup pin plate 62 up and down. Outside the equipment, many backup pins 61 are preliminarily set upright on the backup pin plate 62 in such an arrangement as to correspond to a substrate S. Then, the backup pin plate 62 set with many backup pins is carried into the equipment and mounted on the elevation mechanism 35, 36.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.09.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3499759

[Date of registration]

05.12.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The substrate conveyance device which carries in the substrate with which various configurations differ to a component—mounting location, and is taken out from a component—mounting location, Many backup pins which face so that this may be supported from the bottom to the substrate carried in to the component—mounting location, And the substrate backup unit which has the backup pin—plate set up for the backup pin of said large number by the arrangement to which the carried—in substrate was made to correspond, enabling free attachment and detachment, It is substrate set equipment of the mounter equipped with the unit elevator style which makes it go up and down this while supporting said substrate backup unit removable. Said substrate conveyance device Said substrate backup unit is constituted possible [carrying in] to a component—mounting location, and possible [a component—mounting location to taking out]. Said unit elevator style Substrate set equipment of the mounter characterized by the support condition constituting said substrate backup unit carried in to the component—mounting location possible [a receipt].

[Claim 2] It is substrate set equipment of the mounter according to claim 1 characterized by carrying in and taking out said substrate backup unit according to said substrate conveyance device in the condition of having carried in the unit carrier, and for said unit elevator style going up, and receiving said substrate backup unit from said unit carrier.

[Claim 3] It is substrate set equipment of the mounter according to claim 2 which said unit carrier carried in to the component-mounting location is positioned in the one corner in the substrate set criteria location which positions one corner of a substrate, and said substrate backup unit is in the condition positioned to one corner of said unit carrier, and is characterized by being carried in the unit carrier concerned.

[Claim 4] Substrate set equipment of the mounter according to claim 3 characterized by forming a carrying—in inhibition means to prevent carrying in of the unit carrier concerned which mistook the conveyance direction order at least in one side of said substrate conveyance device and said unit carrier.

[Claim 5] It is substrate set equipment of the mounter according to claim 1 to 4 which either of the top face of said unit elevator style and the inferior surface of tongue of said substrate backup unit is equipped with the magnet, and is characterized by said unit elevator style receiving said substrate backup unit through said magnet.

[Claim 6] It is substrate set equipment of the mounter according to claim 1 to 5 which said unit elevator style has the base plate which can set up many backup pins by the arrangement to which the substrate carried in to the upper part was made to correspond, and is characterized by said unit elevator style receiving said substrate backup unit on the top face of said base plate.

[Claim 7] The backup pin change approach of the mounter characterized by to constitute the backup pin-plate set up for many backup pins, enabling free attachment and detachment free [attachment and detachment] to the elevator style which makes it go up and down the backup pin-plate concerned, to set up out of equipment by the arrangement whose backup pin of said large number was made for said backup pin-plate to correspond to a substrate beforehand, to

carry in the backup pin-plate concerned in equipment in this condition, and to equip said elevator style.

[Claim 8] The backup pin change approach of the mounter according to claim 7 characterized by performing carrying in from the outside of the equipment of said backup pin-plate to into equipment using the substrate conveyance device in which a substrate is carried in and taken out

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the substrate set equipment of a mounter and the backup pin change approach of making many backup pins face so that it may support from the bottom to the carried-in substrate while carrying in a substrate to a component-mounting location.

[0002]

[Description of the Prior Art] The arrangement differs by whether about a substrate, this is supported from a background and hors d'oeuvre components are in the background of the magnitude and thickness of a substrate, and a substrate that bending of a substrate should be prevented in case the backup pin of a large number in the substrate set equipment of a mounter equips a substrate with electronic parts. For this reason, many backup pins are taken out and inserted in the case of a housekeeping substitute of a substrate, and in the conventional mounter, it is rearranging so that it may become suitable arrangement to a new substrate. This rearrangement drives the case where an operator attends a mounter and carries out manually, and the wearing head of a mounter, and may be performed automatically (for example, provisional-publication-of-a-patent No. 108800 [Heisei three to] official report). [0003]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] It is easy to produce incorrect wearing of a backup pin that it is hard to do an activity, in a manual case, the rearrangement activity of a backup pin has the problem to which a wearing mistake (a pin falling) and control system of a backup pin become complicated, when it is automatic, but the problem which spends for time amount more than it to an activity is. That is, the time amount which a housekeeping substitute of a substrate takes was influenced by the working hours of rearrangement of a backup pin, and there was a problem which becomes long.

[0004] It sets it as the purpose that this invention offers the substrate set equipment of a mounter and the backup pin change approach the time amount which a housekeeping substitute of a substrate takes is not influenced by the working hours of rearrangement of a backup pin. [0005]

[Means for Solving the Problem] The substrate conveyance device which the substrate set equipment of this invention carries in the substrate with which various configurations differ to a component-mounting location, and is taken out from a component-mounting location, Many backup pins which face so that this may be supported from the bottom to the substrate carried in to the component-mounting location, And the substrate backup unit which has the backup pin-plate set up for many backup pins by the arrangement to which the carried-in substrate was made to correspond, enabling free attachment and detachment, It is substrate set equipment of the mounter equipped with the unit elevator style which makes it go up and down this while supporting a substrate backup unit removable. A substrate conveyance device A substrate backup unit is constituted possible [carrying in] to a component-mounting location, and possible [a component-mounting location to taking out], and it is characterized by the unit elevator style being constituted by the support condition possible [a receipt] in the substrate

backup unit carried in to the component-mounting location.

[0006] According to this configuration, a substrate backup unit can be carried in to a component-mounting location like a substrate, and a unit elevator style can be equipped in a component-mounting location. That is, many backup pins are set up to the backup pin-plate by the arrangement whose substrate was made to correspond out of equipment, and this can be introduced in equipment like a substrate. Therefore, regardless of a housekeeping substitute of a substrate, the place of the backup pin to degree substrate is changed, and this can be introduced in equipment at the time of a housekeeping substitute, and in case it is a housekeeping substitute of a substrate, it is not necessary to change the place of a backup pin. [0007] In this case, a substrate backup unit is carried in and taken out according to a substrate conveyance device in the condition of having carried in the unit carrier, and, as for a unit elevator style, it is desirable to go up and to receive a substrate backup unit from a unit carrier. [0008] According to this configuration, with a unit carrier, this can be carried in and taken out so that the backup pin of a substrate backup unit may not interfere with other components. Moreover, it is not necessary to make a substrate backup unit into the structure which can be carried in and taken out by the direct substrate conveyance device. Furthermore, this can be conveyed on a single unit carrier to two or more sorts of substrate backup units from which size differs.

[0009] In this case, said unit carrier carried in to the component-mounting location is positioned in that one corner in the substrate set criteria location which positions one corner of a substrate, it is in the condition positioned to one corner of a unit carrier, and, as for a substrate backup unit, being carried in the unit carrier is desirable.

[0010] According to this configuration, you make it go up and down a unit elevator style, and it succeeds in positioning to the equipment (introductory substrate) of the backup pin in a substrate backup unit automatically only by receiving a substrate backup unit.

[0011] In this case, it is desirable that a carrying—in inhibition means to prevent carrying in of a unit carrier which mistook the conveyance direction order is formed at least in one side of a substrate conveyance device and a unit carrier.

[0012] According to this configuration, it can prevent in advance that a unit carrier, as a result a substrate backup unit are introduced in equipment accidentally [order].

[0013] Either of the top face of a unit elevator style and the inferior surface of tongue of a substrate backup unit is equipped with the magnet in these cases, and, as for a unit elevator style, it is desirable to receive a substrate backup unit through a magnet.

[0014] According to this configuration, the substrate backup unit to a unit elevator style can be detached and attached simply and correctly.

[0015] The unit elevator style has the base plate which can set up many backup pins in these cases by the arrangement to which the substrate carried in to the upper part was made to correspond, and, as for a unit elevator style, it is desirable to receive a substrate backup unit on the top face of a base plate.

[0016] According to this configuration, while being able to set a backup pin within equipment like before using a base plate, the substrate backup unit which set the backup pin out of equipment can be introduced in equipment. That is, either in equipment and besides equipment can change the place of a backup pin. Moreover, this means that a substrate backup unit can be introduced also into the existing mounter.

[0017] It carries out that the backup pin change approach of this invention constitutes the backup pin-plate set up for many backup pins, enabling free attachment and detachment free [attachment and detachment] to the elevator style which makes it go up and down a backup pin-plate, sets it up out of equipment by the arrangement many whose backup pins were made for a backup pin-plate to correspond to a substrate beforehand, carries in a backup pin-plate in equipment in this condition, and equips an elevator style with it as the description.

[0018] According to this configuration, a reshuffle of a backup pin can be performed out of equipment. For this reason, regardless of a housekeeping substitute of a substrate, the place of the backup pin to degree substrate is changed, and this can be introduced in equipment at the time of a housekeeping substitute, and in case it is a housekeeping substitute of a substrate, it is

not necessary to change the place of a backup pin.

[0019] In this case, it is desirable to perform carrying in from the outside of the equipment of a backup pin-plate to into equipment using the substrate conveyance device in which a substrate is carried in and taken out.

[0020] According to this configuration, the backup pin-plate which set the backup pin can be introduced in equipment with the same conveyance gestalt as a substrate, and installation into the equipment of a backup pin-plate can be performed simply and efficiently.
[0021]

[Embodiment of the Invention] The case where the substrate set equipment of a mounter and the backup pin change approach concerning 1 operation gestalt of this invention are hereafter applied to the substrate feed zone of a multiple function chip mounter with reference to an accompanying drawing is explained. This mounter is constituted possible [mounting in the substrate with which various gestalten differ various kinds of electronic parts]. As <u>drawing 1</u> is the top view of a mounter and it is shown in this drawing, a mounter 1 Part I article feed zone 4a arranged in the center section of a machine stool 2 and the machine stool 2 at the substrate feed zone 3 which extends in a longitudinal direction, and the anterior part (under illustration) of a machine stool 2, It has part II article feed zone 4b arranged in the posterior part (on illustration) of a machine stool 2, 1st X-Y stage 5a arranged in the anterior part of a machine stool 2 free [migration], and 2nd X-Y stage 5b arranged in the posterior part of a machine stool 2 free [migration].

[0022] 2nd head unit 6b is similarly carried for 1st head unit 6a for adsorbing and equipping the 1X-Y-stage5a with electronic parts in the 2X-Y-stage5b, respectively. Two sets of the wearing heads 8 and 8 equipped with the adsorption nozzle 7 are carried in each head units 6a and 6b, and also the substrate recognition camera 9 is carried between two sets of the wearing heads 8 and 8. Moreover, on the machine stool 2, the substrate feed zone 3 is inserted and two sets of each 1 to 2 sets of part-recognition cameras 10, 10, 10, and 10 and the nozzle stockers 11 and 11 are arranged, respectively. In this case, both the part-recognition cameras 10 and 10 and the nozzle stocker 11 which are located in anterior part correspond to 1st head unit 6a, and both the part-recognition cameras 10 and 10 and the nozzle stocker 11 which are located in a posterior part support 2nd head unit 6b.

[0023] In this mounter 1, small electronic parts, such as a surface mounted device, are mainly supplied from part I article feed zone 4a and part II article feed zone 4b, and large electronic parts, such as multi-lead components, are supplied from the components feed zone of the tray format which is not mainly illustrated. Moreover, a substrate is supplied by the substrate feed zone 3 from a left, is set in the center of a machine stool 2 by immobilization, and is discharged by the method of the right. for example, in mounting of the electronic parts using 1st X-Y stage 5a Part I article feed zone (other components feed zones are good) 4a is made to face 1st head unit 6a by 1st X-Y stage 5a. A substrate is equipped with electronic parts, after adsorbing desired electronic parts, making the part-recognition camera 10 face these electronic parts, carrying out location recognition next, moving 1st head unit 6a to the position of a substrate further and recognizing a substrate location with the substrate recognition camera 9. In addition, 1st X-Y stage 5a and 2nd X-Y stage 5b usually become mutual operation.

[0024] Each of part I article feed zone 4a and part II article feed zone 4b arranges many tape cassettes 12 lining up side—by—side. Where a carrier tape (it omits in illustration) is loaded, electronic parts are held in each tape cassette 12, and one electronic parts are supplied at a time to it from the tip of the tape cassette 12. In the usual operation, when 1st head unit 6a is carrying out wearing actuation, exchange of the tape cassette 12 is performed by part II article feed zone 4b, and when 2nd head unit 6b is carrying out wearing actuation, exchange of the tape cassette 12 is performed by part I article feed zone 4a.

[0025] The 1X-Y-stage5a and 2nd X-Y stage 5b are guided at the Y-axis guide rails 14 and 14 of the pair arranged in the right-and-left both ends of a machine stool 2, and have Y ** beams 15 and 15 which move to a cross direction (Y shaft orientations), respectively. Y ** beam 15 of 1st X-Y stage 5a moves to Y shaft orientations (cross direction) by the Y-axis motor (all are illustration abbreviations) made to rotate the ball thread of a left part, and this. Similarly, Y **

beam 15 of 2nd X-Y stage 5b moves to Y shaft orientations by the Y-axis motor (all are illustration abbreviations) made to rotate the ball thread of the right part, and this. [0026] On the other hand, both Y ** beams 15 and 15 are the same, completely have the X-axis guide rail 16, respectively, are the configurations of a ball thread and an X-axis motor (all are illustration abbreviations), and make each above-mentioned head units 6a and 6b move to X shaft orientations (longitudinal direction) like the above-mentioned drive system. Thus, each head units 6a and 6b are freely movable into X shaft orientations and Y shaft orientations, i.e., a horizontal plane.

[0027] The substrate feed zone 3 has the clamp equipment 21 arranged in the center, the substrate carrying—in device 22 which stands in a row on the left—hand side of [illustration] clamp equipment 21, and the substrate taking—out device 23 which stands in a row on the right—hand side of [illustration] clamp equipment 5. A substrate is supported from the bottom so that it is carried in to clamp equipment 21 from the outside of equipment according to the substrate carrying—in device 22, it may be set to immobilization so that clamp equipment 21 may receive wearing of electronic parts, and it may not bend in the case of components wearing. And the substrate which wearing of electronic parts completed is taken out out of equipment through the substrate taking—out device 23 from clamp equipment 21. In this case, there is a substrate of a supply standby condition in the substrate carrying—in device 22, and there is a substrate of a discharge standby condition in the substrate taking—out device 23 (it omits in illustration), and these substrates are conveyed by passing atrange<a href="mailto:atrange<a href="m

[0028] By the way, although the substrate clamped by clamp equipment 21 is equipped with electronic parts (mounting), he makes the backup pin 34 later mentioned from the background of a substrate that bending of a substrate should be prevented face, and is trying to support this in that case. In case a substrate is a housekeeping substitute of a substrate, it takes out and inserts many backup pins 34, and by whether hors d'oeuvre components are in the background of the magnitude and thickness, and a substrate, since the arrangement differs, it is rearranging them so that it may become suitable arrangement to a new substrate. Then, although prepared for clamp equipment 21 possible [wearing of the backup pin 34] in the mounter 1 of an operation gestalt, apart from this, the substrate backup unit 60 (all are mentioned later) which equipped the backup pin-plate 62 with the backup pin 61 consists of outside of equipment possible [installation] to clamp equipment 21 through the substrate carrying-in device 22. [0029] Here, with reference to <u>drawing 2</u> and <u>drawing 3</u> , clamp equipment 21 is further explained to a detail. In addition, in explanation of the subsequent clamp equipments 21, the conveyance direction (longitudinal direction) of a substrate is made into order (it influences as the mounter 1 whole), and suppose the cross direction of a substrate that explanation is advanced as right and left (before or after [as the mounter 1 whole]).

[0030] Fixed side substrate installation base 31a and movable side substrate installation base 31b to which clamp equipment 21 supports the right-and-left both-sides edge of Substrate S, respectively, The introductory base migration equipment 32 which makes movable side substrate installation base 31b move to a longitudinal direction according to the width of face of the substrate S to introduce, While receiving Substrate S from the substrate carrying-in device 22 and conveying to the predetermined clamp location (component-mounting location) of both the substrates installation bases 31a and 31b It has the substrate concrete supply system 33 of the conveyor format of conveying the substrate S which wearing of electronic parts completed from the clamp location to the substrate taking-out device 23.

[0031] Moreover, clamp equipment 21 is equipped with the backup table 35 on which the backup pin 34 of a large number which attend from the bottom the substrate S set to the clamp location, and support this, and many backup pins 34 were set up, and the backup pin lifting device 36 which makes it go up and down the backup pin 34 through the backup table 35. And fixed side substrate installation base 31a and movable side substrate installation base 31b are arranged so that it may counter, and the backup table 35 and the backup pin lifting device 36 are arranged down [between both substrates installation base 31a and 31b]. In addition, the unit elevator style said to a claim sets this backup table 35 and the backup pin lifting device 36. [0032] The cross-section "KO" character-like guide slot 38 to which it shows the side edge

section of Substrate S is formed in fixed side substrate installation base 31a of the part of the inside, and conveyor roller 33a of the substrate concrete supply system 33 attached in this. Similarly, the cross-section "KO" character-like guide slot 38 to which it shows the side edge section of Substrate S is formed in movable side substrate installation base 31b of the part of the inside, and conveyor roller 33a of the substrate concrete supply system 33 attached in this. Moreover, the pneumatic cylinder 39 has attended the part of the guide slot 38, and the introduced substrate S can be pressed and fixed now between fixed side substrate installation base 31a at movable side substrate installation base 31b.

[0033] The backup table 35 is formed in the plane view abbreviation rectangle, and has each the table base 41 supported by four shafts 40, 40, 40, and 40, the pincette plate 42 for setting up the backup pin 34 laid in the table base 41 bottom, and two or more clamp plates 43 arranged in the both ends of the cross direction of the table base 41. The clamp plate 43 presses down Substrate S from the bottom, and it supports Substrate S only on the clamp plate 43, without using the backup pin 34, when the substrate S with rigidity is introduced.

[0034] On the other hand, many set holes 44 for setting up the backup pin 34 are formed in the pincette plate 42. Although many set holes 44 are distributed throughout the pincette plate 42, the fixed substrate installation base 31a side is a fine pitch, and movable substrate installation base 31b is arranged in the rude pitch in order to make it correspond to the substrate S with which extensive narrow-width one differs. In this case, when it doubles with the magnitude of Substrate S and hors d'oeuvre components are in the rear face of Substrate S, the backup pin 34 escapes, is suitably inserted in the set hole 44, makes this, and is set (wearing). In addition, the signs 45 and 45 in drawing 3 R> 3 are the stoppers for positioning the substrate S order introduced into the component-mounting location, respectively, and use one of the stoppers 45 with a substrate.

[0035] The backup pin lifting device 36 has the rise-and-fall motor outside drawing which makes coincidence go up and down four shafts 40, 40, 40, and 40 which support the backup table 35, the support frame 46 which carried out installation immobilization on the machine stool 2 while supporting these, and four shafts 40. In this case, the rotational motion force of a rise-and-fall motor is transmitted to each shaft 40 and the follower pulley 48 arranged on the same axle through a belt 47, and makes it go up and down each shaft 40 which consisted of ball-thread spline shafts through the rotation block 49. And the backup table 35 which set up the backup pin 34 goes up and down because four shafts 40 go up and down to coincidence.

[0036] The substrate S transported from the substrate carrying-in device 22 is conveyed by both conveyor roller 33a to the clamp location (component-mounting location) collided against a stopper 45. Then, a pneumatic cylinder 39 operates and Substrate S is fixed to immobilization in the cross direction. Next, the backup pin lifting device 36 operates and the clamp plate 42 supports Substrate S from the bottom to immobilization. In addition, in that case, BAAAPPUPIN 34 consists a gap slightly in fact, and stands face to face against Substrate S. If wearing of electronic parts is performed to Substrate S in this condition and wearing is completed, immobilization of Substrate S will be solved in a procedure contrary to the above, and Substrate S will be transported to the substrate taking-out device 23 by both conveyor roller 33a. [0037] Next, with reference to drawing 4 and drawing 5, how to introduce the substrate backup unit 60 equivalent to the above-mentioned backup pin 34 and the above-mentioned pincette plate 42 from the outside of equipment is explained. In this case, the substrate backup unit 60 which set the backup pin 61 is carried in the unit carrier 70, is introduced through the substrate carrying-in device 22 completely like the case where a substrate is introduced, and is received on the pincette plate 42. Moreover, in the case of a housekeeping substitute, the empty unit carrier 70 is sent in from the outside of equipment, and he transfers the substrate backup unit 60 to the unit carrier 70 from the pincette plate 42, and is trying to take out out of equipment through the substrate taking-out device 23 like a substrate in this condition.

[0038] The substrate backup unit 60 consists of a pincette plate 42, a backup pin-plate 62 which has many set holes 63 similarly, and many backup pins (product made of resin) 61 with which this is equipped. However, as for the backup pin-plate 62, some kinds of different things of size are prepared. Moreover, the backup pin 61 is set to the backup pin-plate 62 by the pattern

corresponding to a substrate as well as the above-mentioned backup pin 34. Of course, this set activity (reshuffle activity of extraction and insertion) is separated from operation of a mounter 1, and is performed out of equipment. In addition, the through tubes 64 and 64 for positioning on the unit carrier 70 are formed in two places of the direction of a long side of the backup pin-plate 62 independently [the above-mentioned set hole 63].

[0039] On the other hand, the unit carrier 70 has the substrate, the same carrier plate 71 tabular [rectangular], the fixed buttress plate 72 and the movable buttress plate 73 that were attached in right and left of the inferior surface of tongue of the carrier plate 71, and the handle 74 of a pair before and after attaching in the top face of the carrier plate 71. The fixed buttress plate 72 and the movable buttress plate 73 are formed in the shape of a cross-section "abbreviation S" character, and as they counter, they are arranged. And the substrate backup unit 60 is laid so that it may pass between piece of bottom horizontal discharge 72a of both the buttress plates 72 and 73, and 73a. In addition, the dropping dimension of the fixed buttress plate 72 and the movable buttress plate 73 is the dimension which the backup pin 61 cannot use for the carrier plate 71, also when the backup pin 61 set up to the backup pin-plate 62 cannot not only be used for the carrier plate 71, but raises the backup pin-plate 62 for a transfer.

[0040] The upward projection 75 of an order pair is formed in piece of bottom horizontal discharge 72a of the fixed buttress plate 72, the through tube 64 of the backup pin-plate 62 fits into this upward projection 75, and the substrate backup unit 60 is positioned by the unit carrier 70. By this positioning, the location of the substrate backup unit 60 and the backup pin 61 more specifically set up to this and the front end (in fact location of the corner of one of these) of the carrier plate 71 of the unit carrier 70 are positioned correctly. From the unit carrier 70 carried in to a component-mounting location like a substrate by this, when the substrate backup unit 60 is transferred to the backup table 35 (transferred by vertical migration), the backup pin 61 will be correctly positioned to equipment in this phase.

[0041] The upper limit section of the movable buttress plate 73 is being fixed to the carrier plate 71 by the lever 76 with the screw thread of an order pair. That is, the movable buttress plate 73 is concluded by the unit carrier 71 by the lever 76 through the long hole 77 prolonged in the longitudinal direction formed in the carrier plate 71. As mentioned above, some kinds of things from which size differs are prepared, the backup pin-plate 62 solves immobilization by this lever 76, and the substrate backup unit 60 from which size differs on the unit carrier 70 can be carried now by carrying out adjustable [of the location of the movable buttress plate 73] along with a long hole 77.

[0042] The cross-section "abbreviation S" character-like piece 78 of a plate is attached in the location which approached crosswise one side of the center of a top face of the carrier plate 71, the upper part was crooked and the piece 78 of a plate is protruded crosswise from the carrier plate 71. In case the unit carrier 70 is introduced in equipment, the unit carrier 70 is set to the substrate carrying-in device 22, but if the unit carrier 70 order is mistaken, the sensor 24 of the substrate carrying-in device 22 can be choked with this piece 78 of a plate, and it can set no longer. That is, a carrying-in inhibition means to prevent carrying in of the unit carrier 70 which mistook order by the piece 78 of a plate and the sensor 24 is constituted.

[0043] On the other hand, a right-and-left pair and the receptacle blocks 50 and 50 of two articles are attached in the top face of the pincette plate 42 which receives the unit carrier 70 in equipment. The receptacle block 50 consists of magnets, it is adsorbing the substrate backup unit 60 from the bottom, and it is made into a wearing condition on the pincette plate 42 while it receives this. The locating lug 51 of an order pair protrudes on the top face of the receptacle block 50, this locating lug 51 fits into the predetermined set hole 63 of the backup pin-plate 62, and the substrate backup unit 60 is positioned for while it is located in the above-mentioned stopper 45 side by the pincette plate 42. In addition, you may make it attach the receptacle block 50 in the inferior surface of tongue of the substrate backup unit 60.

[0044] Next, with reference to <u>drawing 6</u> and <u>drawing 7</u>, the introductory procedure of the substrate backup unit 60 is explained. First, set the backup pin-plate 62 on the fixture outside drawing out of equipment (<u>drawing 6</u> (a)), a substrate is made to correspond, and it equips with many backup pins 61 on the backup pin-plate 62 (<u>drawing 6</u> (reshuffle) (b)). Next, this substrate

backup unit 60 is put on the unit carrier 70 (setting), and it sets to the substrate carrying—in device 22 in this condition (drawing 6 (c)). The substrate feed zone 3 is made to drive here. [0045] By this, the substrate concrete supply system 33 of the substrate carrying—in device 2 and clamp equipment 21 drives first, and the unit carrier 70 is carried in to a component—mounting location like a substrate, and this is fixed (drawing 7 (a)). Next, the backup pin lifting device 36 drives and the backup table 35 is raised. If the backup table 35 goes up, while the receptacle block 50 will run against the backup pin—plate 62 and adsorbing this, touch with the unit carrier 70 is made to lose (drawing 7 (b)). Namely, the receptacle block 50 adsorbs the substrate backup unit 60, and changes into the condition of having set this to the backup table 35.

[0046] Then, the substrate concrete supply system 33 and the substrate taking—out device 23 drive, the empty unit carrier 70 is conveyed to them, and this is taken out out of equipment (<u>drawing 7</u> (c)). Moreover, the backup pin lifting device 36 drives, the backup table 35 which laid the substrate backup unit 60 is dropped, and it returns to a position in readiness at the same time the unit carrier 70 is taken out from a component—mounting location. Henceforth, a substrate is introduced and it moves to the usual mounting actuation.

[0047] On the other hand, when introducing the new substrate backup unit 60 on the occasion of a housekeeping substitute, the substrate backup unit 60 is delivered and it is made to go up to a location through the backup table 35 in advance of the installation first. Next, the empty unit carrier 70 is carried in to a component-mounting location through the substrate carrying-in device 22 (drawing 7 (d)). Under the present circumstances, the unit carrier 70 is introduced so that both those buttress plates 72 and 73 may be hidden in the substrate backup unit 60 bottom. Here, the backup table 35 is dropped and the substrate backup unit 60 is delivered to the unit carrier 70 (drawing 7 (e)). And the unit carrier 70 which carried the substrate backup unit 60 is taken out out of equipment through the substrate taking-out device 23.

[0048] As mentioned above, according to this operation gestalt, since the set (reshuffle) of the backup pin 61 is performed out of equipment, and this is introduced using the substrate carrying—in device 22 in the case of a housekeeping substitute of a substrate and he is trying to set to the backup table 35, the place of the backup pin 61 can be changed at the time of not a housekeeping substitute of a mounter 1 but operation. That is, the reshuffle activity of the backup pin 61 which requires time amount most among the housekeeping substitute activities over degree substrate can be done in parallel to operation of a mounter 1. Therefore, the time amount which a housekeeping substitute takes can be shortened extremely.

[0049] In addition, although it is made to carry in a substrate backup unit in equipment in the condition of having carried in the unit carrier (taking out), it is not necessary to necessarily use a unit carrier, and you may make it carry in a substrate backup unit like a substrate with this operation gestalt. Moreover, although a substrate carrying—in device and a substrate taking—out device are used and he is trying to carry in and take out the unit carrier which carried the substrate backup unit to the inside of equipment, an operator may be made to carry in and set a substrate backup unit in equipment directly. Furthermore, this invention is applicable also to the so—called high—speed mounter (rotary system).

[Effect of the Invention] As mentioned above, since the backup pin is set up to the backup pinplate by the arrangement which made the substrate correspond out of equipment and he is trying to introduce this in equipment like a substrate, it is not necessary to change the place of a backup pin according to the substrate set equipment of this invention, and the backup pin change approach, in the case of a housekeeping substitute of a substrate. Therefore, the time amount which the time amount which a housekeeping substitute of a substrate takes is not influenced by the working hours of rearrangement of a backup pin, and a housekeeping substitute takes can be shortened extremely.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the top view of the mounter which applied the substrate set equipment and the backup pin change approach concerning 1 operation gestalt of this invention to the substrate feed zone.

[Drawing 2] It is the front view of the substrate feed zone (clamp equipment) concerning an operation gestalt.

[Drawing 3] It is the top view of the substrate feed zone (clamp equipment) concerning an operation gestalt.

[Drawing 4] It is the front view showing the condition of having carried out substrate backup unit installation in the substrate feed zone concerning an operation gestalt.

[Drawing 5] It is the top view showing the condition of having carried out substrate backup unit installation in the substrate feed zone concerning an operation gestalt.

[Drawing 6] It is the explanatory view showing the backup pin change approach (1).

[Drawing 7] It is the explanatory view showing the backup pin change approach (2).

[Description of Notations]

- 1 Mounter
- 3 Substrate Feed Zone
- 21 Clamp Equipment
- 22 Substrate Carrying-in Device
- 23 Substrate Taking-Out Device
- 24 Sensor
- 33 Substrate Concrete Supply System
- 34 Backup Pin
- 35 Backup Table
- 36 Backup Lifting Device
- 42 Pincette Plate
- 50 Receptacle Block
- 60 Substrate Backup Unit
- 61 Backup Pin
- 62 Backup Pin-plate
- 63 Set Hole
- 64 Through Tube
- 70 Unit Carrier
- 75 Upward Projection
- 78 Piece of Plate
- S Substrate

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-124690 (P2000-124690A)

(43)公開日 平成12年4月28日(2000.4.28)

(51) Int.Cl.?

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H05K 13/04

H05K 13/04

Q 5E313

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 10 頁)

(21)出願番号	特題平10-289786	(71)出願人 000001889		
	•	三洋電機株式会社		
(22)出顧日	平成10年10月12日(1998.10.12)	大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号		
		(72)発明者 茂原 正之		
		大阪府守口市京都	反本通2丁目5番5号 三	
		洋電機株式会社	4	
		(72)発明者 大山 和義	•	
			反本通2丁目5番5号 三	
		洋電機株式会社内		
			3	
		(74)代理人 100093964		
		弁理士 落合 希	3	

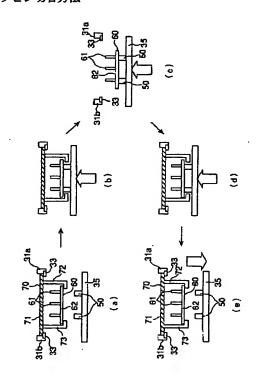
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 マウンタの基板セット装置およびバックアップピン切替方法

(57)【要約】

【課題】 基板の段取り替えに要する時間が、バックア ップピンの並替えの作業時間に左右されることのない、 マウンタの基板セット装置およびバックアップピン切替 方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 多数のバックアップピン61を着脱自在 に立設するバックアップピンブレート62を、バックア ップピンプレート62を昇降させる昇降機構35,36 に対し着脱自在に構成し、装置外において、予めバック アップピンプレート62に多数のバックアップピン61 を基板Sに対応させた配置で立設しておき、この状態で バックアップピンプレート62を装置内に搬入して昇降 機構35,36に装着するものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 各種形状の異なる基板を部品実装位置まで搬入し且つ部品実装位置から搬出する基板搬送機構

部品実装位置に搬入した基板に下側からこれを支持する ように臨む多数のパックアップピン、および搬入した基 板に対応させた配置で前記多数のパックアップピンを着 脱自在に立設したパックアップピンプレートを有する基 板パックアップユニットと、

前記基板バックアップユニットを着脱可能に支持すると 共にこれを昇降させるユニット昇降機構とを備えたマウンタの基板セット装置であって、

前記基板搬送機構は、前記基板バックアップユニットを 部品実装位置まで搬入可能且つ部品実装位置から搬出可 能に構成され、

前記ユニット昇降機構は、部品実装位置に搬入した前記 基板バックアップユニットを支持状態に受取り可能に構 成されていることを特徴とするマウンタの基板セット装 置。

【請求項2】 前記基板バックアップユニットは、ユニ 20 ットキャリアに搭載した状態で前記基板搬送機構により 搬入・搬出され、

前記ユニット昇降機構は、上昇して前記ユニットキャリアから前記基板バックアップユニットを受け取ることを特徴とする請求項1に記載のマウンタの基板セット装置。

【請求項3】 部品実装位置に搬入された前記ユニットキャリアは、その1つの角部を基板の1つの角部を位置 決めする基板セット基準位置に位置決めされ、

前記基板バックアップユニットは、前記ユニットキャリアの1つの角部に対し位置決めされた状態で、当該ユニットキャリアに搭載されていることを特徴とする請求項2に記載のマウンタの基板セット装置。

【請求項4】 前記基板搬送機構と前記ユニットキャリアの少なくとも一方には、搬送方向の前後を誤った当該ユニットキャリアの搬入を阻止する搬入阻止手段が設けられていることを特徴とする請求項3に記載のマウンタの基板セット装置。

【請求項5】 前記ユニット昇降機構の上面と前記基板 バックアップユニットの下面とのいずれか一方には、マ グネットが装着されており、

前記ユニット昇降機構は、前記マグネットを介して前記 基板バックアップユニットを受け取ることを特徴とする 請求項1ないし4のいずれかに記載のマウンタの基板セット共開

【請求項6】 前記ユニット昇降機構は上部に、搬入した基板に対応させた配置で多数のパックアップピンを立設可能なベースプレートを有しており、

的記ユニット昇降機構は、前記ベースプレートの上面で 前記基板バックアップユニットを受け取ることを特徴と 50 する請求項1ないし5のいずれかに記載のマウンタの基 板セット装置。

【請求項7】 多数のバックアップピンを着脱自在に立 設するバックアップピンプレートを、当該バックアップ ピンプレートを昇降させる昇降機構に対し着脱自在に構 成し

装置外において、予め前記バックアップピンプレートに 前記多数のバックアップピンを基板に対応させた配置で 立設しておき、この状態で当該バックアップピンプレー トを装置内に搬入して前記昇降機構に装着することを特 徴とするマウンタのバックアップピン切替方法。

【請求項8】 前記バックアップピンプレートの装置外から装置内への搬入を、基板を搬入・搬出する基板搬送機構を用いて行うことを特徴とする請求項7に記載のマウンタのバックアップピン切替方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、部品実装位置に基 板を搬入すると共に、搬入した基板に下側から支持する ように多数のバックアップピンを臨ませるマウンタの基 板セット装置およびバックアップピン切替方法に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】マウンタの基板セット装置における多数のバックアップピンは、基板に電子部品を装着する際に、基板の撓みを防止すべく基板を裏側からこれを支持するものであり、基板の大きさや厚み、基板の展側に先付け部品があるか否かなどにより、その配置が異なる。このため、従来のマウンタでは、基板の段取り替えの際に多数のバックアップピンを抜き差しして、新たな基板に対し適切な配置になるように並び替えている。この並び替えは、作業者がマウンタに臨んで手動で行う場合と、マウンタの装着ヘッドを駆動して自動で行う場合(例えば特開平成3-108800号公報)とがある、【0003】

【発明が解決しようとする課題】バックアップピンの並替え作業は、手動の場合には作業がし難くバックアップピンの誤装着が生じ易く、自動の場合にはバックアップピンの装着ミス(ピンの倒れ)や制御系が複雑になる問題があるが、それ以上に作業に時間がかかる問題がある。すなわち、基板の段取り替えに要する時間が、バックアップピンの並び替えの作業時間に左右され、長くなる問題があった。

【0004】本発明は、基板の段取り替えに要する時間が、バックアップピンの並替えの作業時間に左右されることのない、マウンクの基板セット装置およびバックアップピン切替方法を提供することをその目的としている。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の基板セット装置

は、各種形状の異なる基板を部品実装位置まで搬入し且 つ部品実装位置から搬出する基板搬送機構と、部品実装 位置に搬入した基板に下側からこれを支持するように臨 む多数のパックアップピン、および搬入した基板に対応 させた配置で多数のパックアップピンを者脱自在に立設 したパックアップピンプレートを有する基板パックアッ プユニットと、基板パックアップユニットを着脱可能に 支持すると共にこれを昇降させるユニット昇降機構とを 備えたマウンタの基板セット装置であって、基板搬送機 構は、基板パックアップユニットを部品実装位置まで搬 入可能且つ部品実装位置から搬出可能に構成され、ユニット昇降機構は、部品実装位置に搬入した基板パックアップユニットを表板パックアップユニットを支持状態に受取り可能に構成されている ことを特徴とする。

【0006】この構成によれば、基板バックアップユニットを基板と同様に部品実装位置まで搬入することができ、且つ部品実装位置でユニット昇降機構に装着することができる。すなわち、装置外において、基板に対応させた配置で多数のバックアップピンをバックアップピンプレートに立設しておき、これを基板と同様に装置内に 20 導入することができる。したがって、基板の段取り替えに関係なく、次基板に対するバックアップピンの配置替えを行っておき、段取り替え時にこれを装置内に導入することができ、基板の段取り替えの際に、バックアップピンの配置替えを行う必要がない。

【0007】この場合、基板バックアップユニットは、 ユニットキャリアに搭載した状態で基板搬送機構により 搬入・搬出され、ユニット昇降機構は、上昇してユニッ トキャリアから基板バックアップユニットを受け取るこ とが、好ましい。

【0008】この構成によれば、ユニットキャリアにより、基板バックアップユニットのバックアップピンが他の構成装置と干渉しないように、これを搬入・搬出することができる。また、基板バックアップユニットを、直接基板搬送機構で搬入・搬出できるような構造にする必要がない。さらに、サイズの異なる複数種の基板バックアップユニットに対し、単一のユニットキャリアでこれを搬送することができる。

【0009】この場合、部品実装位置に搬入された前記 ユニットキャリアは、その1つの角部を基板の1つの角 40 部を位置決めする基板セット基準位置に位置決めされ、 基板バックアップユニットは、ユニットキャリアの1つ の角部に対し位置決めされた状態で、ユニットキャリア に搭載されていることが、好ましい。

【0010】この構成によれば、ユニット昇降機構を昇降させて、基板バックアップユニットを受け取るだけで、基板バックアップユニットにおけるバックアップピンの装置(導入基板)に対する位置決めが自動的に為される

【0011】この場合、基板鍛送機構とユニットキャリ 50

アの少なくとも一方には、搬送方向の前後を誤ったユニットキャリアの搬入を阻止する搬入阻止手段が設けられていることが、好ましい。

【0012】この構成によれば、ユニットキャリア、ひいては基板バックアップユニットが前後を誤って装置内に導入されるのを、事前に防止することができる。

【0013】これらの場合、ユニット昇降機構の上面と 基板パックアップユニットの下面とのいずれか一方に は、マグネットが装着されており、ユニット昇降機構 は、マグネットを介して基板バックアップユニットを受 け取ることが、好ましい。

【0014】この構成によれば、ユニット昇降機構に対する基板バックアップユニットの着脱を簡単かつ正確に行うことができる。

【0015】これらの場合、ユニット昇降機構は上部に、搬入した基板に対応させた配置で多数のバックアップピンを立設可能なベースプレートを有しており、ユニット昇降機構は、ベースプレートの上面で基板バックアップユニットを受け取ることが、好ましい。

【0016】この構成によれば、従来のようにベースプレートを利用して、装置内でバックアップピンをセットすることができると共に、装置外でバックアップピンをセットした基板バックアップユニットを、装置内に導入することができる。すなわち、装置内および装置外のいずれでも、バックアップピンの配置替えを行うことができる。またこのことは、既存のマウンタにも、基板バックアップユニットを導入可能であることを意味する。

【0017】本発明のバックアップピン切替方法は、多数のバックアップピンを着脱自在に立設するバックアップピンプレートを昇降させる昇降機構に対し着脱自在に構成し、装置外において、予めバックアップピンプレートに多数のバックアップピンを基板に対応させた配置で立設しておき、この状態でバックアップピンプレートを装置内に搬入して昇降機構に装着することを特徴とする。

【0018】この構成によれば、バックアップピンの配置替えを装置外で行うことができる。このため、基板の段取り替えに関係なく、次基板に対するバックアップピンの配置替えを行っておき、段取り替え時にこれを装置内に導入することができ、基板の段取り替えの際に、バックアップピンの配置替えを行う必要がない。

【0019】この場合、バックアップピンプレートの装置外から装置内への搬入を、基板を搬入・搬出する基板搬送機構を用いて行うことが、好ましい。

【0020】この構成によれば、バックアップピンをセットしたバックアップピンプレートを、基板と同様な搬送形態で、装置内に導入することができ、バックアップピンプレートの装置内への導入を、簡単且つ効率よく行うことができる。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して、本発明の一実施形態に係るマウンタの基板セット装置およびバックアップピン切替方法を、多機能チップマウンタの基板供給部に適用した場合について説明する。このマウンタは、各種の電子部品を各種形態の異なる基板に実装可能に構成されている。図1はマウンタの平面図であり、同図に示すように、マウンタ1は、機台2と、機台2の中央部に左右方向に延在する基板供給部3と、機台2の前部(図示の下側)に配設した第1部品供給部4aと、機台2の後部(図示の上側)に配設した第2部品供 10給部4bと、機台2の前部に移動自在に配設した第1XYステージ5aと、機台2の後部に移動自在に配設した第2XYステージ5bとを備えている。

【0022】第1XYステージ5aには、電子部品を吸着および装置するための第1ヘッドユニット6aが、同様に第2XYステージ5bには、第2ヘッドユニット6bがそれぞれ搭載されている。各ヘッドユニット6a,6bには、吸着ノズル7を装着した2台の装着ヘッド8,8が搭載されている他、2台の装着ヘッド8,8の間に基板認識カメラ9が搭載されている。また、機台2上には、基板供給部3を挟んで、各一対2組の部品認識カメラ10,10よいカ11,11とが、それぞれ配設されている。この場合、前部に位置する両部品認識カメラ10,10およびノズルストッカ11は第1ヘッドユニット6aに対応し、後部に位置する両部品認識カメラ10,10およびノズルストッカ11は第2ヘッドユニット6bに対応している。

【0023】このマウンタ1では、表面実装部品などの 小さい電子部品は、主に第1部品供給部4aおよび第2 部品供給部4bから供給され、多リード部品など大きい 電子部品は、主に図示しないトレイ形式の部品供給部か ら供給される、また、基板は、基板供給部3により左方 から供給されて機台2の中央に不動にセットされ、右方 に排出される。例えば、第1XYステージ5aを用いる 電子部品の実装では、第1 X Y ステージ5 a により、第 1ヘッドユニット6 a を第1部品供給部(他の部品供給 部でも可) 4 a に臨ませ、所望の電子部品を吸着し、次 にこの電子部品を部品認識カメラ10に臨ませて位置認 職し、更に第1ヘッドユニット6aを基板の所定の位置 40 まで移動させて、基板認識カメラ9で基板位置を認識し た後、電子部品を基板に装着する。なお、通常、第1X Yステージ5aと第2XYステージ5bとは交互運転と なる。

【0024】第1部品供給部4aおよび第2部品供給部4bは、いずれも多数のテープカセット12を横並びに配設したものである。各テープカセット12には、キャリアテープ(図示では省略)に装填された状態で電子部品が収容され、電子部品はテープカセット12の先端から1つずつ供給される。通常の運転において、第1ヘッ50

ドユニット6 a が装着動作している場合には、第2部品 供給部4bでテープカセット12の交換作業が行われ、 第2ヘッドユニット6bが装着動作している場合には、 第1部品供給部4aでテープカセット12の交換作業が 行われる。

【0025】第1XYステージ5aおよび第2XYステージ5bは、機台2の左右両端部に配設した一対のY軸ガイドレール14,14に案内されて、前後方向(Y軸方向)に移動するY動ビーム15,15を、それぞれ有している。第1XYステージ5aのY動ビーム15は、左部のボールねじおよびこれを回転させるY軸モータ(いずれも図示省略)により、Y軸方向(前後方向)に進退する。同様に、第2XYステージ5bのY動ビーム15は、右部のボールねじおよびこれを回転させるY軸モータ(いずれも図示省略)により、Y軸方向に進退する。

【0026】一方、両Y動ビーム15,15は全く同一のものであり、それぞれX軸ガイドレール16を有し、上記の駆動系と同様に、ボールねじおよびX軸モータ(いずれも図示省略)の構成で、上記の各ヘッドユニット6a,6bをX軸方向(左右方向)に進退させる。このように、各ヘッドユニット6a,6bは、X軸方向およびY軸方向、すなわち水平面内において移動自在となっている。

【0027】基板供給部3は、中央に配設したクランプ装置21と、クランプ装置21の図示左側に連なる基板 搬入機構22と、クランプ装置5の図示右側に連なる基板搬出機構23とを有している。基板は、基板搬入機構22により、装置外からクランプ装置21に搬入され、クランプ装置21で電子部品の装着を受けるべく下動にセットされ、且つ部品装着の際に撓まないように下側から支持される。そして、電子部品の装着が完了した基板は、クランプ装置21から基板搬出機構23を介して基板付機出される。この場合、基板搬入機構22には供給待機状態の基板が有り、また基板搬出機構23には排出待機状態の基板が有り(図示では省略)、これら基板は順送りで搬送される。

【0028】ところで、クランブ装置21にクランプされた基板に、電子部品が装着(実装)されるが、その際、基板の撓みを防止すべく基板の裏側から後述するバックアップピン34を臨ませて、これを支持するようにしている。基板は、その大きさや厚み、基板の裏側に先付け部品があるか否かなどにより、その配置が異なるため、基板の段取り替えの際に多数のバックアップピン34を抜き差しして、新たな基板に対し適切な配置になるように並び替えている。そこで、実施形態のマウンタ1では、クランプ装置21に、バックアップピン34を装着可能に備えるが、これとは別に、バックアップピンプレート62にバックアップピン61を装着した基板バックアップユニット60(いずれも後述する)を、基板機

入機構22を介して装置外からクランブ装置21に導入 可能に構成している。

【0029】ここで、図2および図3を参照して、クランプ装置21について更に詳細に説明する。なお、以降のクランプ装置21の説明では、基板の搬送方向(長手方向)を前後(マウンタ1全体としては左右)とし、基板の幅方向を左右(マウンタ1全体としては前後)として説明を進めることとする。

【0030】クランプ装置21は、基板Sの左右両側端部をそれぞれ支持する固定側基板導入台31aおよび可動側基板導入台31bと、導入する基板Sの幅に合わせて可動側基板導入台31bを左右方向に進退させる導入台移動装置32と、基板Sを基板搬入機構22から受け取って両基板導入台31a,31bの所定のクランプ位置(部品実装位置)まで搬送すると共に、電子部品の装着が完了した基板Sをクランプ位置から基板搬出機構23まで搬送するコンベア形式の基板移送装置33とを備えている。

【0031】また、クランプ装置21は、クランプ位置にセットされた基板Sに下側から臨みこれを支持する多数のバックアップピン34と、多数のバックアップピン34を昇降させるバックアップピン昇降装置36とを備えている。そして、固定側基板導入台31aと可動側基板導入台31bとは、対向するように配設され、またパックアップテーブル35とパックアップピン昇降装置36とは、両基板導入台31a、31b間の下方に配設されている。なお、請求項にいうユニット昇降機構は、このバックアップデーブル35とバックアップピン昇降装置3 306とを合わせたものである。

【0032】固定側基板導入台31aには、その内側の部位と、これに取り付けた基板移送装置33のコンベアローラ33aとにより、基板Sの側端部を案内する断面「コ」字状のガイド構38が形成されている。同様に、可動側基板導入台31bには、その内側の部位と、これに取り付けた基板移送装置33のコンベアローラ33aとにより、基板Sの側端部を案内する断面「コ」字状のガイド構38が形成されている。また、可動側基板導入台31bには、ガイド構38の部分にエアーシリンダ39が臨んでおり、導入した基板Sを固定側基板導入台31aとの間で押圧・固定できるようになっている。

【0033】バックアップテーブル35は、平面視略方形に形成されており、4本のシャフト40, 40, 40, 40, 40に支持されたテーブルベース41と、テーブルベース41の上側に載置したバックアップピン34を立設するためのピンセットプレート42と、テーブルベース41の幅方向の両端部に配設した各複数枚のクランプブレート43とを有している。クランプブレート43は、基板Sを下側から押さえるものであり、剛性のある50

基板Sが導入された場合には、バックアップピン34を 用いることなく、クランププレート43のみで基板Sを 支持する。

【0034】一方、ピンセットプレート42には、バックアップピン34を立設するための多数のセット孔44が形成されている。多数のセット孔44は、ピンセットプレート42の全域に分布しているが、広狭幅の異なる基板Sに対応させるべく、固定基板導入台31a側は細かいピッチで且つ可動基板導入台31bは荒いピッチで配設されている。この場合、バックアップピン34は、基板Sの大きさに合わせ、且つ基板Sの裏面に先付け部品がある場合にはこれを逃げて、適宜セット孔44に差し込まれるようにしてセット(装着)される。なお、図3中の行号45,45は、それぞれ部品実装位置に導入された基板Sの前後を位置決めするためのストッパであり、基板によりいずれかのストッパ45を使用する。【0035】バックアップピン昇降装置36は、バック

てップテーブル35を支持する4本のシャフト40, 40, 40と、これらを支持すると共に機台2上に 載置固定した支持フレーム46と、4本のシャフト40 を同時に昇降させる図外の昇降モータを有している。この場合、昇降モータの回転動力は、ベルト47を介して 各シャフト40と同軸上に配設した従動プーリ48に伝達され、回転ブロック49を介してボールねじスプラインシャフトで構成された各シャフト40を昇降させる。 そして、4本のシャフト40が同時に昇降することで、バックアップピン34を立設したバックアップテーブル35が昇降する。

【0036】基板搬入機構22から移送された基板Sは、両コンペアローラ33aにより、ストッパ45に突き当たるクランプ位置(部品実装位置)まで搬送される。続いてエアーシリンダ39が作動して、基板Sを幅方向において不動に固定する。次に、パックアップピン昇降装置36が作動して、クランププレート42が基板Sを下側から不動に支持する。なお、その際バッアップピン34は、実際にはわずかに間隙を存して基板Sに対時する。この状態で基板Sに対し電子部品の装着が行われ、装着が完了すると上記と逆の手順で基板Sの固定が解かれ、基板Sは、両コンペアローラ33aにより基板搬出機構23に移送される。

【0037】次に、図4および図5を参照して、上記のバックアップピン34およびピンセットプレート42に相当する基板バックアップユニット60を、装置外から導入する方法について説明する。この場合、バックアップピン61をセットした基板バックアップユニット60は、ユニットキャリア70に搭載され、基板を導入する場合と全く同様に基板搬入機構22を介して導入され、ピンセットプレート42上に受け取られる。また、段取り替えの際には、装置外から空のユニットキャリア70を送り込み、基板バックアップユニット60をピンセッを送り込み、基板バックアップユニット60をピンセッ

トプレート42からユニットキャリア70に移載し、こ の状態で基板と同様に、基板搬出機構23を介して装置 外に搬出するようにしている。

【0038】基板バックアップユニット60は、ピンセ ットプレート42と同様に、多数のセット孔63を有す るバックアップピンプレート62と、これに装着される 多数のバックアップピン(樹脂製)61とで構成されて いる。ただし、バックアップピンプレート62はサイズ の異なる数種類のものが用意されている。また、バック アップピン61は上記のバックアップピン34と同様 に、基板に対応されたパターンでパックアップピンプレ ート62にセットされる。もちろん、このセット作業 (抜き差しの配置替え作業) は、マウンタ1の稼働と切 り離して装置外で行われる。なお、バックアップピンプ レート62の長辺方向の2箇所には、上記のセット孔6 3とは別に、ユニットキャリア70に位置決めするため

の貫通孔64、64が形成されている。

【0039】一方、ユニットキャリア10は、基板と同 様の方形板状のキャリアプレート71と、キャリアプレ ート71の下面の左右に取り付けた固定支持プレート7 2および可動支持プレート73と、キャリアプレート7 1の上面に取り付けた前後一対の取っ手74とを有して いる、固定支持プレート72および可動支持プレート7・ 3は、断面略「S」字状に形成され、対向するようにし て配設されている、そして、両支持プレート72,73 の下部水平片72a, 73a間に渡すように、基板バッ クアップユニット60が載置される。なお、固定支持プ レート72および可動支持プレート73の下垂寸法は、 バックアップピンプレート62に立設したバックアップ ピン61が、キャリアプレート71につかえないだけで 30 なく、移載のためにバックアップピンプレート62を持 ち上げたときにも、バックアップピン61がキャリアプ レート71につかえない寸法となっている。

【0040】固定支持プレート72の下部水平片72a には、前後一対の上向き突起75が設けられており、こ の上向き突起75にパックアップピンプレート62の貫 通孔64が嵌合して、基板バックアップユニット60が ユニットキャリア70に位置決めされる。この位置決め により、基板バックアップユニット60、より具体的に はこれに立設したバックアップピン61の位置と、ユニ 40 ットキャリア70のキャリアプレート71の前端(実際 にはその一方の角部の位置)とが、正確に位置決めされ る。これにより、基板と同様に部品実装位置に搬入され るユニットキャリア70から、基板パックアップユニッ ト60がバックアップテーブル35に移載(上下移動で 移載される)されると、この段階で、パックアップピン 61は装置に対し正確に位置決めされることになる。

【0041】可動支持プレート73の上端部は、前後一 対のねじ付きのレバー76により、キャリアブレート7 1に固定されている。すなわち、可動支持プレート73 so ル35を上昇させる。バックアップテーブル35が上昇

は、キャリアプレート71に形成した左右方向に延びる 長孔77を介して、レバー76によりユニットキャリア 71に締結されている。上述したように、バックアップ ピンプレート62はサイズの異なる数種類のものが用意 されており、このレパー76により固定を解いて、長孔 77に沿って可動支持プレート73の位置を可変させる ことで、ユニットキャリア70にサイズの異なる基板バ ックアップユニット60を搭載できるようになってい

【0042】キャリアブレート71の上面中央の幅方向 片側に寄った位置には、断面略「S」字状の板片78が 取り付けられており、板片78は、上部が屈曲してキャ リアプレート71から幅方向にはみ出している。ユニッ トキャリア70を装置内に導入する際には、基板搬入機 構22にユニットキャリア70をセットするが、ユニッ トキャリア 70の前後を間違えると、この板片 78が基 板搬入機構22のセンサ24につかえて、セットするこ とができないようになっている。すなわち、板片78と センサ24とにより、前後を誤ったユニットキャリア7 0の搬入を阻止する搬入阻止手段が、構成されている。 【0043】一方、装置内において、ユニットキャリア 70を受けるピンセットプレート42の上面には、左右 一対、2条の受けブロック50,50が取り付けられて いる。受けブロック50は、マグネットで構成されてお り、基板バックアップユニット60を下側から吸着する ことで、これを受け取ると共にピンセットブレート42 上に装着状態とする。上記のストッパ45側に位置する 一方の受けブロック50の上面には、前後一対の位置決 め突起51が突設されており、この位置決め突起51 が、バックアップピンプレート62の所定のセット孔6 3に嵌合して、基板バックアップユニット60が、ピン セットプレート42に位置決めされる。なお、受けプロ ック50を、基板パックアップユニット60の下面に取 り付けるようにしてもよい。

【0044】次に、図6および図7を参照して、基板バ ックアップユニット60の導入手順について説明する。 先ず、装置外において、図外の冶具上にバックアップピ ンプレート62をセットし(図6(a))、基板に対応 させてバックアップピンプレート62上に多数のバック アップピン61を装着する(配置替え)(図6

(b))。次に、この基板バックアップユニット60を ユニットキャリア70に乗せ(セットし)、この状態で 基板搬入機構22にセットする(図6 (c))。ここ で、基板供給部3を駆動させる。

【0045】これにより、先ず基板搬入機構2およびク ランプ装置21の基板移送装置33が駆動して、ユニッ トキャリア70を、基板と同様に部品実装位置に搬入 し、且つこれを固定する(図7(a))。次に、バック アップピン昇降装置36が駆動してバックアップテープ

10

すると、受けブロック50がパックアップピンプレート 62に突き当たってこれを吸着すると共に、ユニットキ ャリア70から浮き上がらせる(図7(b))。すなわ ち、受けブロック50が基板パックアップユニット60 を吸着して、これをバックアップテーブル35にセット した状態にする。

【0046】続いて、基板移送装置33および基板搬出 機構23が駆動して、空のユニットキャリア70を先方 に搬送し、これを装置外に搬出する(図7 (c))。ま ると同時に、バックアップピン昇降装置36が駆動し て、基板バックアップユニット60を載置したバックア ップテーブル35を下降させ、待機位置に戻る。以降、 基板を導入して通常の実装動作に移る。

【0047】一方、段取り替えに際し、新たな基板バッ クアップユニット60を導入する場合には、その導入に 先立ち、先ずバックアップテーブル35を介して、基板 バックアップユニット60を受渡し位置まで上昇させ る。次に、基板搬入機構22を介して、空のユニットキ ャリア70を部品実装位置に搬入する(図7(d))。 この際、ユニットキャリア70は、その両支持プレート 72,73が、基板バックアップユニット60の下側に 潜り込むように導入される、ここで、バックアップテー ブル35を下降させて、基板バックアップユニット60 をユニットキャリア70に受け渡す(図7(e))。そ して、基板バックアップユニット60を搭載したユニッ トキャリア70を、基板搬出機構23を介して装置外に 搬出する。

【0048】以上のように本実施形態によれば、バック アップピン61のセット(配置替え)を装置外で行って 30 おいて、これを基板の段取り替えの際に、基板搬入機構 22を利用して導入し、且つバックアップテーブル35 にセットするようにしているので、バックアップピン6 1の配置替えを、マウンタ1の段取り替え時ではなく、 稼働時に行うことができる。すなわち、次基板に対する 段取り替え作業のうち、最も時間を要するバックアップ ピン61の配置替え作業を、マウンタ1の稼働と並行し て行うことができる。したがって、段取り替えに要する 時間を極端に短縮することができる。

【0049】なお、本実施形態では、基板パックアップ 40 ユニットをユニットキャリアに搭載した状態で装置内に 搬入(搬出)するようにしているが、必ずしもユニット キャリアを用いる必要はなく、基板バックアップユニッ トを基板と同様に搬入するようにしてもよい。また、基 板バックアップユニットを搭載したユニットキャリア を、基板搬入機構および基板搬出機構を利用して、装置 内に対し搬入・搬出するようにしているが、作業者が、 基板パックアップユニットを直接、装置内に搬入しセッ トナるようにしてもよい。さらに、本発明は、いわゆる 高速マウンタ (ロータリー式) にも、適用可能である。

[0050]

【発明の効果】以上のように本発明の基板セット装置お よびバックアップピン切替方法によれば、装置外におい て、基板に対応させた配置でバックアップピンをバック アップピンプレートに立設しておき、これを基板と同様 に装置内に導入するようにしているので、基板の段取り 替えの際に、バックアップピンの配置替えを行う必要が ない。したがって、基板の段取り替えに要する時間が、 バックアップピンの並び替えの作業時間に左右されるこ た、ユニットキャリア70が部品実装位置から搬出され 10 とのなく、段取り替えに要する時間を極端に短縮するこ とができる。

12

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に係る基板セット装置およ びバックアップピン切替方法をその基板供給部に適用し たマウンタの平面図である。

【図2】実施形態に係る基板供給部(クランプ装置)の 正面図である.

【図3】実施形態に係る基板供給部 (クランプ装置) の 平面図である。

【図4】実施形態に係る基板供給部に基板バックアップ ユニット導入した状態を示す正面図である。

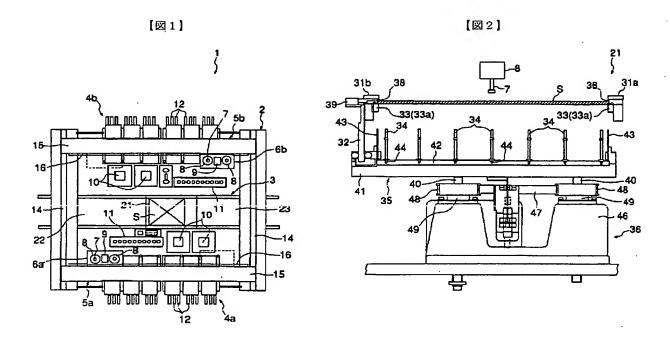
【図5】 実施形態に係る基板供給部に基板バックアップ ユニット導入した状態を示す平面図である。

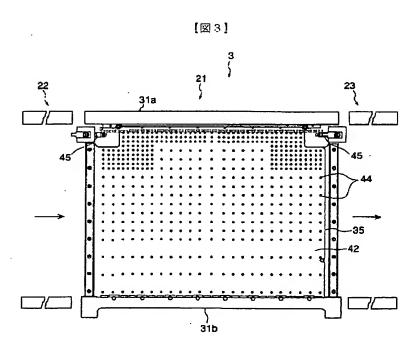
【図6】バックアップピン切替方法(1)を示す説明図

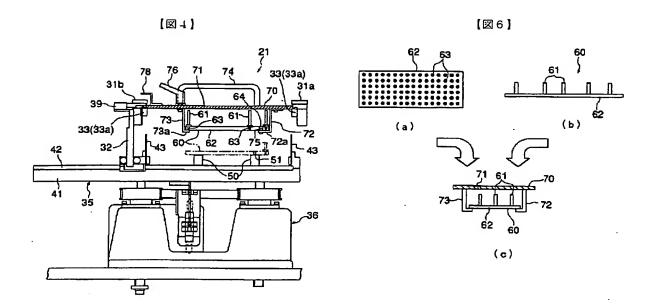
【図7】バックアップピン切替方法(2)を示す説明図 である。

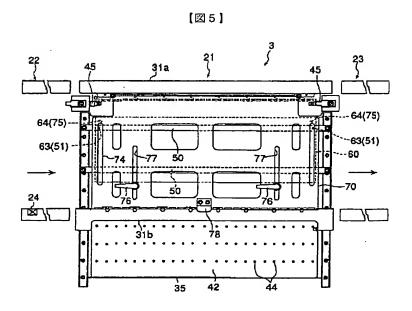
【符号の説明】

- 1 マウンタ
- 3 基板供給部
- 21 クランプ装置
- 22 基板搬入機構
- 23 基板搬出機構
- 24 センサ
- 33 基板移送装置
- 34 バックアップピン
- 35 バックアップテーブル
- 36 バックアップ昇降装置
- 42 ピンセットプレート
- 50 受けブロック
 - 60 基板パックアップユニット
 - 61 バックアップピン
 - 62 バックアップピンプレート
 - 63 セット孔
 - 64 貫通孔
 - 70 ユニットキャリア
 - 75 上向き突起
 - 78 板片
 - S 基板

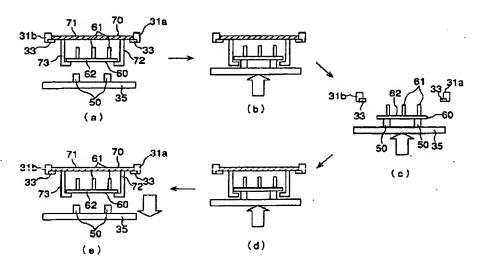








【図7】



フロントページの続き

(72) 発明者 栗原 繁

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内

(72)発明者 主山 修二

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内

Fターム(参考) 5E313 AA11 CC01 EE05 EE50

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.